



数据表

VL805

4 端口 USB 3.0 主机控制器

2014年9月4日 修订版0.93

威盛实验室有限公司

www.via-labs.com

7F, 529-1, Zhongzheng Rd., Xindian District, New Taipei City 231 Taiwan 电话: (886-2)2218-1838

传真: (886-2)2218-8924

电子邮件: <u>sales@via-labs.com.tw</u>

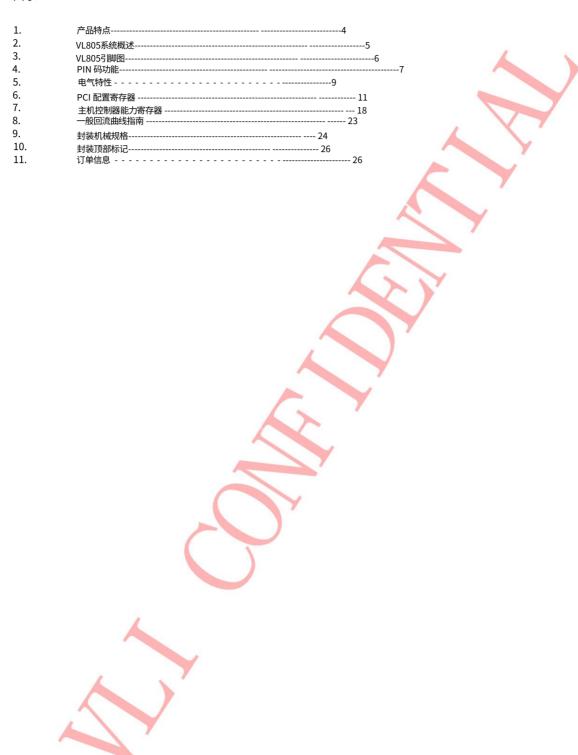


修订记录

版本号 状态*	日期	作者 变更原因/说明	
085	2012/11/13 约翰	1.添加中国充电 2.添加内部UAS/Turbo驱动程序 3.添加兼容Windows 8内置驱动	
086	2012/11/30 约翰	1.添加Linux驱动支持 2.添加主机控制器功能寄存器和主机控制器 3.添加工作温度	运行时寄存器
087	2012/12/13 约翰	1、细化机械规格图。	7
088	2013/03/18 约翰	1.修复一些打字错误	
090	2013/05/27 约翰	1. 在VL806引脚图上添加三角形标记。	
091	2013/09/05 约翰。	1.添加VCCA33SSM的引脚描述	
092	2013/11/29 约翰	1.修改驱动支持	
093	2014/9/4 约翰	1. 添加零件编号以获取订单信息	



目录





一、产品特点

-扩展坞

VL805 4 端口 USB 3.0 主机控制器 符合通用串行总线 3.0 规范修订版 1.0 -支持所有传输类型:控制、批量、流、中断、同步 符合通用串行总线2.0规范 符合可扩展主机控制器接口 (xHCI) 规范修订版 1.0 - 所有超高速端口均支持 USB 调试功能 支持传统USB功能 -四个下行端口支持超高速 (SS)、高速 (HS)、全速 (FS) 和 支持电池充电规范-符合电池充电规范修订版 1.2 - Apple 充电-中国 充电 固件升级 -支持在Microsoft DOS和Windows XP、Vista下使用软件工具进行固件升级, Windows 7, Windows 8. -在系统 BIOS 中集成固件的选项(用于板载设计。) 符合 PCI Express 基本规范 2.0 -支持 Express 卡标准 内部USB和PCIe PHY采用先进的CMOS工艺来降低功耗 功耗-3.3 V 和 1.05 V 电源- USB 3.0 低功耗状态支持 系统时钟 - 25 MHz 晶体 软件 - Windows 8/8.1、Windows 7的初始 xHCI 主机控制器驱动程序支持-仅批量传输 (BOT) - USB 连接 SCSI 协议 (UASP) 模式-在 Windows 7 上提供内部 UAS/Turbo 驱动程序。 -与 Windows 8/8.1 盒装驱动程序兼容。 - 兼容 Linux 内核 3.2.53 及更高版本的 Linux xHCI 驱动程序。 身体方面 - QFN 68 绿色封装 (8x8) 应用 -主板 -笔记本电脑/上网本 -运通卡 -附加卡 -嵌入式系统



2.VL805系统概述

VLI VL805 是一款单芯片 USB 3.0 主机控制器 ,使配备 PCI Express 的平台能够与 USB 超高速 (5 Gbps),高速 (480 Mbps),全速 (12 Mbps) 和低速 (12 Mbps) 接口。 1.5 Mbps)设备。根集线器由两个面向下游的端口组成,允许最多 31 个外围设备同时运行。 VL805 具有 x1 PCI Express 2.0 总线接口,向后兼容 PCI Express 1.0。

VL805 符合通用串行总线 3.0 规范和英特尔可扩展主机控制器接口 (xHCI),并完全向后兼容 USB 2.0 和 1.1 规范,确保传统 USB 设备的无缝连接。

凭借精心规划的引脚排列和先进的工艺,基于 VL805 的器件在紧凑的占地面积内具有简单的布局和较低的工作温度。边带信号引脚可用于显示电源启用、过流和 LED 状态。 VL805 采用 QFN 68 绿色封装 (8x8 mm),适合小型设计。

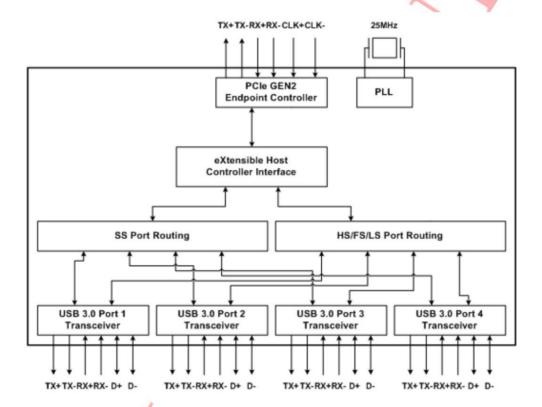
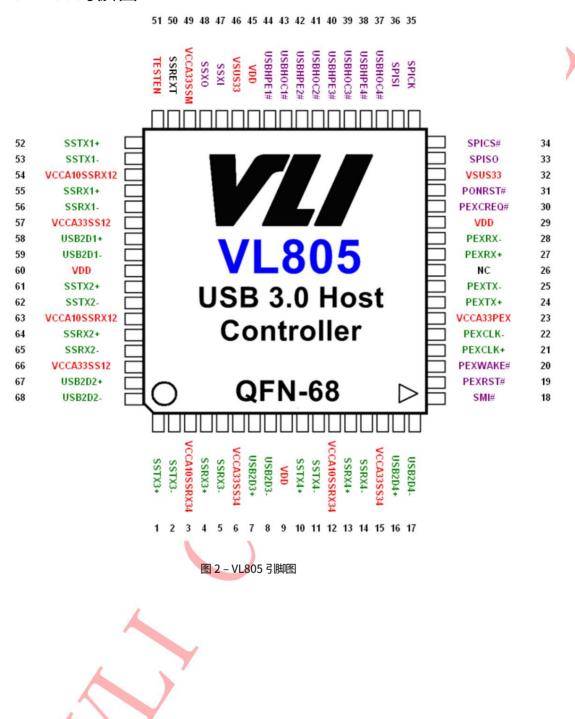


图 1 – VL805 框图



3.VL805引脚图



4. 密码功能

信号类型定义			
姓名	类型	信号说明	
输入	我	标准仅输入	
输出	氧	标准主动驱动	动器
输入输出	输入/输出	双向信号	
漏极开路	Ж	允许多个设在	备以线或方式共享。
模拟差分	阿迪夫	双绞线接口的	的信号对
模拟偏置或 参考信号	ABIAS	必须连接到	外部电阻,如系统原理图所示。
力量	压水堆	一个电源	引脚
地面		一个接地	
电源和接地			
引脚名称	引脚#	输入/输出	信号说明
电源电压	9,29,45,60	压水堆	1.05V核心电源
VSUS33	32,46	压水堆	3.3V 暂停电源
	32,40	EDIVE	3.3V 賀字电源
PCI Express x1 接口	DIEL #		
引脚名称 VCCA22DEV 22	别针 #	输入/输出	信号说明
VCCA33PEX 23		压水堆	PCIE 物理层 3.3V
PEXTX0+24		阿迪夫	PCIE差分传输数据+
PEXTX0-25		阿迪夫	PCIE 差分传输数据 -
PEXRX0+ 27		阿迪夫	PCIE差分接收数据+
PEXRX0-28		阿迪夫	PCIE 差 <mark>分接收数</mark> 据 -
PEXCLK+ 21		阿迪夫	PCIE差分参考时钟+/-。PCIE对外提供100MHz的差分时钟。允许并建
PEXCLK-22		阿迪夫	议 使用 SSC(扩频时钟)在 +300ppm 和 – 2300ppm 范围内。
模拟命令块		4	
引脚名称	别针#	输入/输出	信号说明
SXXI 47		R	25M晶振输入,可在SSXO不接的情况下交替由外部时钟源(1.05V摆幅主电源)驱动。
SSXO	48	氧	
SSSREXT	50	阿比亚斯	连接到带隙参考电阻,以在该引脚和接地之间添加一个外部 6.04K(1%) 电阻,以实现 SuperSpeed USB
SPI闪存接口			
引脚名称	引脚 #	输入/输出	信号说明
SPICS#	34	氧	SPI 片选
SPIS时钟	35	 氧	SPI串行时钟输入
著作	36	<u></u> 氧	SPI串行数据输入
н			



USB 3.0 根集线器接口 引脚名称 引脚# SSTX1+	- 52 SSTX1-	4	冷 显光明
		输入/输出	信号说明
53 SSRX1+ 55 SSRX1-		阿迪夫	USB 3.0 DP1口差分传输数据+
VCCA10SSRX12 54,63		阿迪夫	USB 3.0 DP1端口差分传输数据 -
VCCA33SS12 57,66 SS		阿迪夫	USB 3.0 DP1口差分接收数据+
61 SSTX2- 62 SSRX2+	64	阿迪夫	USB 3.0 DP1 端口差分接收数据 -
SSRX2- 65 SSTX3+ _{1 S}		压水堆	USB PHY 1.05V USB
SSRX3+ 4 SSRX3 - 5 V(CCA10SSRX34	压水堆	PHY 3.3V 暂停电源
3,12 VCCA33SS34 6,1		阿迪夫	USB 3.0 DP2口差分传输数据+
SSTX4+ 10 SSTX4- 11	SSRX4+	 阿迪夫	USB 3.0 DP2端口差分传输数据 -
13 SSRX4- 14 VCCA33	SSM	阿迪夫	USB 3.0 DP2口差分接收数据+
		阿迪夫	USB 3.0 DP2 端口差分接收数据 -
		阿迪夫	USB 3.0 DP3口差分传输数据+
		阿迪夫	USB 3.0 DP3端口差分传输数据 -
		阿迪夫	USB 3.0 DP3口差分接收数据+
		阿迪夫	USB 3.0 DP3 端口差分接收数据 -
		压水堆	USB PHY 1.05V USB
		压水堆	PHY 3.3V 暂停电源
		阿迪夫	USB 3.0 DP4口差分传输数据+
		阿迪夫	USB 3.0 DP4端口差分传输数据 -
		阿迪夫	USB 3.0 DP4口差分接收数据+
		阿迪夫	USB 3.0 DP4 端口差分接收数据 -
	49		
USB 2.0 根集线器接口		100 J. P.	USB 3.3V PLL 暂停电源
引脚名称 引脚# USB2D1-	+ 58 USB2D1-	输入/输出	信号说明
59 USB2D2+ 67 USB2D		阿迪夫	
			USB 2.0 DP1 总线数据增强版 (D+)
USB2D3+ 7 USB2D3- 8	U3BZD4+	阿迪夫	USB 2.0 DP1 总线数据减 (D-)
16 USB2D4- 17		阿迪夫	USB 2.0 DP2 总线数据增强版 (D+)
		阿迪夫	USB 2.0 DP2 总线数据减 (D-)
		阿迪夫	USB 2.0 DP3 总线数据增强版 (D+)
		阿迪夫	USB 2.0 DP3 总线数据减 (D-)
		阿迪夫	USB 2.0 DP4 总线数据增强版 (D+)
		阿迪夫	USB 2.0 DP4 总线数据减 (D-)
测试针		~	
引脚名称	引脚# 51	输入/输出	信号说明
去测试		8	测试模式启用
			正常操作时请勿连接。
マホンエムク	20		内部下拉。
预订的 边带信号和杂项	26		
引脚名称	别针 #	输入/输出	信号说明
USBHPE1# 44		从	DP1 电源使能
USBHPE2# 42		<u>ж</u>	DP2 电源使能
USBHPE3# 40		 Ж	
USBHPE3# 40 USBHPE4# 38			DP3 电源使能
			DP4 电源使能
USBHOC1#43		A R	DP1 过流指示器
USBHOC2# 41		#	DP2 过流指示器
USBHOC3#39		#	DP3 过流指示器
USBHOC4# 37		R	DP4 过流指示器
庞斯特#31		R	上电复位信号。
PEXCREQ#30	7	氧	PCIE Express "CLKREQ#"信号。请求运行/停止参考时钟。
PEXRST#	19	R	系统重置。 PCI Express 重置。当 PEXRST# 被置为低电平时,芯片执行内部系统确件复位。
SMI#	18	Ж	系统管理中断。要通过 BIOS 支持 USB 功能,需要将此引脚连接到平台芯片组。如果BIOS不支持USB功能,只需用10K电阻拉至3.3V即可。
PEX唤醒#	20	Ж	链接重新激活。系统醒来。该信号被置为低电平以重新激活 PCI Express 插槽的 主电源轨和参考时钟。



5. 电气特性

5.1 工作条件

符号 参数 VCCA	10 模拟 1.05V 电	分钟。典	型值。最大	限度。单元	Ē
源 VCCA33 模拟	3.3V 电源 VDD 数字内核电源 VSUS33	1.0 1	.05 1.1 1	光	
Aux Power 3.3	电源 PEXRST# VIH	3.0 3	.3 3.6 伏	1	
		1.0 1	.05 1.11	犬	/
		3.03	.3 3.6 伏		Y
	PCIE复位输入高电压	2.03	.3 3.6 伏		
PEXRST# 将要	PCIE复位输入低电压	-0.5	0	0.8V	
饰面	工作环境温度	0		70	Ç

5.2 绝对最大额定值

符号 参数 VCCA	10 模拟 1.05V 电	 额定值	单位
源 VCCA33 模拟	3.3V 电源 VDD 数字内核电源	-0.5 至 +1.4 V	
		-0.5 至 +4.6V	
		-0.5 至 +1.4V	
VSUS33 Aux Po	wer 3.3 电源 -0.5 至 +4.6 V		

5.3 PCI Express 参考时钟

符号参数		分钟。最大队	度。单位	
Ξ	上升沿速率	0.6	4.0	电压/纳秒
特福尔	下降沿速率	0.6	4.0	电压/纳秒
艾滋病病毒	差分输入高电压+150			毫伏
将要	差分输入低电压		-150毫伏	
V交叉	绝对交叉点电压 +250 +550 mV			
交叉三角洲	VCROSS 在所有上升时钟 edgw 上的变化		+140毫伏	
VRB	回铃电压裕度	-100+100뎤	伏	
稳定表	允许VRB之前的时间500			附注
TPERIOD AVG₹	均时钟周期精度 -300 +2800 ppm			
T期ABS	绝对周期(包括抖动) 9.847 10.203 ns 和扩频)			
VCCYTTER	周期抖动		150 皮秒	



最大电压	绝对最大输入电压	+1.15V	
最小电压	绝对最小输入电压	-0.3V	
ZC-DC	时钟源直流阻抗40	60Ω	
	工作周期 40	60%	
	上升沿速率与下降沿速率匹配	20%	1

5.4 USB 接口

	2017			
象征	参数	分钟。	最大	单位
	输出引脚阻抗	限度。 40	.5 49.5 Ω	*
低速/全速输入	 包平		1	
艾滋病病毒	高电平输入电压(驱动)2.0		7	在
出口	高电平输入电压(悬空)	2.7	3.6	在
将要	低电平输入电压		0.8	在
VDI	差分输入灵敏度	0.2		在
氯乙烯CM	差分输入共模范围	0.8	2.5	在
低速/全速的输出	出电平			
沃赫	高电平输出电压	2.8	3.6	在
音量	低电平输出电压	0.0	0.3	在
VOSE1	SE1	0.8		在
可变电阻器	输出信号交叉点电压	1.3	2.0	在
高速输入电平				
VHSSQ	高速静噪检测阈值(差分信号)	100 150毫亿	犬	
VHSDSC	高速断开 525 625 检测阈值(差分 信号)			毫伏
超高速复合材料	高速数据信号共模电压范围	-50	+500毫伏	
高速输出电平				
超高速SOI	高速空闲状态	-10	+10毫伏	
超高压氧	高速数据信号 高 360 440 mV			



The Control of the Co	<u> </u>	300 : -	0.0 T [/ [] T [] []	
超高速索尔	高速数据信号低-10		+10毫伏	
VCHIRPJ	Chrip J 电平(差分信号) 700 1100 mV			
VCHIRPK	Chrip K电平(差分信号) -900 -500 mV			1

6. PCI配置寄存器

标头寄存器 (00-3Fh)

偏移地址:01-00h 供应商 ID 默认值:1106h

位属性		默认	描述	K		助记符
15:0	反渗透	1106h 威盛科	技 ID 代码		Y	在

偏移地址:03-02h

设备 ID 默认值:3483h

位属性		默认		ħ	描述	7	助记符
15:0	反渗透	3483h 设备 IE)代码	1			大卫

<u>偏移地址:05-04h (D18F0)</u> PCI 命令默认值:0000h

位属性		默认	描述	助记符
15:11	反渗透	0	预订的	预订的
10	RW	0	中断禁用	你输入
9	反渗透	0	预订的	预订的
8	RW	0	SERR 启用	塞伦
7	反渗透	0	预订的	预订的
6	RW	0	奇偶校验错误响应	RPTYERR
5	反渗透	0	预订的	预订的
4	反渗透	0	内存写入和无效	MWRMEN
3	反渗透	0	保留特殊循环 监控。 固定为 0b(不支持)。	预订的
2	RW	0	总线主控 内存空	宝马斯特伦
1	RW	0	间 1/0 空间	多媒体空间
0	RW	0		IOS空间



偏移地址:07-06h PCI 状态默认值:0010h

I CI 1	(念默认恒:0010h					
位属性縣			描述		助记符	
15	RW1C	0	检测到奇偶校验错误	检测到奇偶校验错误		
14	RW1C	0	收到信号系统错误主设备中止(特	系统错误		
13	RW1C	0	殊周期除外) 0:未收到中止信息 1:事务被Master中止		TMABORTS	
12	RW1C	0	收到目标中止 0:未收到中止信息 1:交易被目标中止	A	TTABORTR	
11	RW1C	0	发信号通知目标中止 DEVSEL# 时		斯塔伯特	
10:9	反渗透	0	序 固定为 01b。 00:快速 10:慢速主	01:中	德维塞尔TM	
	RW1C	0	数据奇偶校验错误固定为 01h		MDPR错误	
8	反渗透	ال/01	(对于 PCI PMI)	预订的		
	反渗透		中断状态保留		INTRSTS	
7:4 3 2	2:0 反渗透	时00			预订的	

偏移地址:08h

修订 ID 默认值:01h

少量	属性	默认	描述	助记符
7:0	反渗透	00点	修订版 ID	瑞维德

<u>偏移地址:0B-09h (D18F0)</u> 类别代码默认值:0C0330h

少量	属性默认值		描述	助记符
23:0	反渗透	0C0330h	USB3.0 XHCI 主机控制器的类代码	分类码

偏移地址:0Ch

缓存行大小默认值:00h

少量	属性默认值			描述	助记符
7:0	RW	0	缓存行大小		高速缓存线

偏移地址:0Dh

MINION CHE TO DIT	
7.ボトローウローロロ風ト・1 /士・0.01	

少量	属性	默认	描述	助记符
7:0	反渗透	0	延迟定时器	拉特马

偏移地址:0Eh

少量	属性默认值		描述	助记符
7:0	反渗透	00点	标头类型	高清类型



偏移地址:0Fh

内置自测试 (BIST) 默认值:00h

位属性		默认	描述	助记符
7:0	反渗透	0	是 固定在 00h	是

偏移地址:13-10h

XHCI 内存映射 I/O 低基地址默认值:00000004h

位属性		默认	描述		助记符
31:1	RW	0	XHCI 内存映射 I/O 寄存器低基地址		基地址0
			USB 3.0 XHCI MMIO 寄存器基址的内存地址。		_ ' È
11:3	反渗透		保留基地址		预订的
2:1	反渗透	0 10b	类型 读取 10b 以进行 64 位寻址。	4	条形类型0
0	反渗透	0	预订的	7	预订的

·<u>偏移地址 17-14h (D18F0)</u> XHCI 内存映射 I/O 高基址默认值 :00000000h

位属性		默认	描述 XHCI 内存 助记符			
31:0	RW	0	映射 I/O 寄存器高基地址 USB 3.0 XHCI MMIO 寄存器基址的内存地址。	基地址0 _你好		

偏移地址:18-2Bh (D18F0) - 保留

偏移地址:2D-2Ch (D18F0)

子系统供应商 ID 默认值:1106h

位属性		默认	描述	助记符
15:0	RW	1106小时	子系统供应商 ID	系统视频识别码

<u>偏移地址:2F-2Eh</u>

子系统 ID 默认值:3483h

位属性		默认	1	描述	助记符
15:0 RV	V	3483小时	子系统ID		SUBSID

偏移地址:30-33h 保留

<u>偏移地址:34h</u>

能力指针默认值:80h

位属性	默认	描述	助记符
7:0 反渗透	80小时	能力指针 该寄存器包含距配置空间开头的偏移地址。 固定在80h。	CAPTR



偏移地址:35-3Bh 保留

偏移地址:3Ch

中断	线	默认值:00h			
位属性		默认	1	苗述	助记符
7:0	RW	0	USB 中断路由 h00:禁用 h02: 保留 h04:IRQ4 h06:IRQ6 h08:IRQ8 h0a:IRQ10 h0c:IRQ12 h0e:IRQ14	h01:IRQ1 h03:IRQ3 h05:IRQ5 h07:IRQ7 h09:IRQ9 h0b:IRQ11 h0d:IRQ13 其他禁用	国际网络

偏移地址:3Dh

中断引脚默认值:01h

14/					
位属性		默认	描述	R	助记符
7:0	反渗透	01小时	中断引脚		INTPIN

偏移地址:3E-3Fh 保留

XHCI 特定配置寄存器 (40-FFh)

偏移地址:40-43h 保留

偏移地址:48-4Bh

XHCI CRCR 镜像低位寄存器默认值:00000000h

位属性默认值		描述	助记符
31:0 RO	0	XHCI CRCR 镜像低位寄存器	CRCR_MIRR 或_LO

偏移地址:4C-4Fh 保留

偏移地址:50-53h

XHCI MCU 固件版本 默认值:0000000h

位属性		默认	描述	助记符
31:0	反渗透	0	XHCI MCU固件版本	固件版本

偏移地址:5C-5Dh

软件的子系统供应商 ID 默认值:1106h

位属性	默认	描述	助记符
15:0 RW	1106小时	子系统供应商 ID(软件可以更新)	SYSVID_SW



偏移地址:5E-5Fh

软件子系统 ID 默认值:3483h

位属性		默认	描述	助记符
15:0 RV	٧	3483h 子系统	D(软件可以更新)	SUBSID_SW

偏移地址:60h

串行总线版本号 (SBRN) 默认值:30h

	心线似乎与 (SDKIN)	//V///////////////////////////////////		
位属性	默认值		描述	助记符
7:0	反渗透	30小时	串行总线规范版本号。 所有其他组合均被保留。 位[7:0] 版本号 30小时发布3.0	SBRN

<u>偏移地址:61h</u>

	·度调整 (FLADJ) 默i	<u> 人值:20h</u>		
位属性		默认	描述	助记符
7:6	活性氧	0	保留的帧长度	预订的
5:0 胜	皆世界	20小时	定时值。 该寄存器的每个十进制值更改对应于 16	FLADJ
			高速位时间。 SOF 周期时间(生成 S <mark>OF 计数器时钟周期的数</mark> 量)	
			SOF 微帧长度)等于 59488 + 该字段中的值。默认值为十进制 32	
			(20h),SOF 循环时间为 60000。 镜框长度	
			(# HS 位时间)FLADJ 值 (十进制) (十进制) 59488 0 (00h)	
			59504 1 (01小时) 59520 2 (02小时	
			59984 31 (1Fh)	
			6000032(20小时)	
		(60480 62 (3Eh) 60496 63 (3Fh)	

偏移地址:78-7Bh

XHCI 可选位配置地址默认值:00000000h

位属性		默认	描述	助记符
31:2 0	反渗透	0	预订的	预订的
19:0 RV	V	0	XHCI 选项位配置地址。	OPTCFGADD 右

偏移地址:7C-7Fh

XHCI 可选位配置数据默认值:00000000h

位属性		默认	描述	助记符
31:0	RW	0	XHCI 选项位配置数据。	OPTCFGDAT A



偏移地址:80h

电源	电源管理能力 ID 默认值:01h						
位属性	默认值		描述	助记符			
7:0	活性氧	01小时	电源管理能力ID	PMCAPID			

偏移地址:81h

	项指针 1	默认值	1:90h	
位属性	默认值		描述	助记符
7:0	活性氧	90小时	下一项指针 1	PMNXTPTR

偏移地址:82-83h

由源管理能力默认值:48	026

	默认值		描述	助记符
15:0	活性氧	4803h 电源管理	能力	PMCAP

偏移地址:84-85h

电源管理能力控制/状态默认值:0000h

		WW(H-0000II		
位属性		默认	描述	助记符
15	现实世界	0	项目管理人员状态 0:未激活 1:活跃	PME状态
14:9	活性氧	0	预订的	预订的
8	现实世界	0	PME 启用 0:禁用 1:启用	中小企业
7:2	活性氧		预订的	预订的
1:0	现实世界	0 00b	电源状态 00:D0	PM状态

偏移地址:86-8Fh

偏移地址:90h

MSI 功能 ID 默认值:05h

位属性		默认		描述	助记符
7:0	反渗透	05点	MSI 功能 ID		MSIID

<u>偏移地址:91h</u> 下一项指针 2

- 10	-项指针 2	默认任	1:C4h	
位属性默认值			描述助	
7:0	反渗透	C4h	下一项指针 2	微星NXTPTR



偏移地址:92-93h

	W + 1-1-18	Ī
MSI	消自控制(計) 值:0084h	

位属性		默认	描述	助记符
15:9	反渗透	0	保留每向量屏	预订的
8	反渗透	0	蔽功能 1:函数支持 MSI 每向量屏蔽 0:函数不支持 MSI 每向量屏蔽	MSIMSKCAP
7	反渗透	1b	64 位地址能力 1:函数能够发送 64 位消息地址。 0:函数无法发送 64 位消息地址。	微星DDR64 帽
6:4	RW	0	启用多消息 软件写入该字段以指示分配的向量的数量。分配的向量数量与 2 的幂对 齐。 000:分配 1 个向量 001:分配2个向量 010:分配4个向量 100:分配16个向量 100:分配16个向量 110:保留	微星MLTEN
3:1	反渗透	010b	多消息功能 系统软件读取该字段以确定请求的向量的数量。 000:分配 1 个向量 001:分配2个向量 010:分配4个向量 011:分配8个向量 100:分配16个向量 100:分配732个向量 110:保留 110:保留	马尔卡普
0	RW	0	MSI 启用如果 MSI-X 消息控制寄存器中的 MSI-X 启用为 1 且为 0,则允许该功能使用 MSI-X 清求服务,并禁止使用其 INTx 引脚。如果为 0,则禁止该功能使用 MSI 请求服务。	微星

<u>偏移地址:94-97h</u> MSI 消息地址低位默认值:00000000h

<u> </u>	月尽地址1四世队队11.	J000000011		
位属性		默认	描述	助记符
31:2	RW	0	消息地址(低 32 位)。 系统指定的消息地址。	MSIADDRLO
1:0	反渗透	0	预订的	预订的

偏移地址:98-9Bh

MSI 消息地址高位默认值:00000000h

	/ 1/C/v C/ 11 -1 -1 //// // // // // // // // // // // //			
位属性		默认	描述消息地址	助记符
31:0	RW	0	(高 32 位)。 系统指定的消息地址。	MSADDRHI

偏移地址:9C-9Dh 微星数据 默认值:0000h

	-> 10</th <th>(H_1000011</th> <th></th> <th></th>	(H_1000011		
位属性		默认	描述	助记符
15:0	RW	0	消息数据。 系统指定的消息数据。	微星数据

偏移地址:9E-FFh 保留



7. 主机控制器能力寄存器

主机控制器能力寄存器(Base+00h-Base+1Bh)

注意:在本文档中,主机控制器的 MMIO 地址空间的开头称为 PCI 配置空间的 Rx10h 处的基地址寄存器。

偏移地址:00h (USB3.0-MMIO)

能力寄存器长度 (CAPLENGTH) 默认值:20h

少量	属性	默认	描述功能寄存	助记符
7:0	反渗透	20小时	器长度 该寄存器用作添加到寄存器基址的偏移量,以找到操作寄存器的开头 空间。	长度

<u>偏移地址:01h (USB3.0-MMIO) – 保留</u>

<u>偏移地址:03-02h(USB3.0-MMIO)</u>

主机控制器接口版本号 (HCIVERSION)

默认值:0100h

少量	属性	默认	描述	助记符
15:0	反渗透	0100时	主机控制器接口版本号 这是一个两字节寄存器,包含支持的 xHCl 规范修订号的 BCD 编码 通过该主机控制器。该寄存器的最高有效字节代表主要修订,最低有效字节代 表 重要字节是次要修订。例如 0100h 对应于 xHCl 版本 1.0。	HC版本

<u>偏移地址:07-04h(USB3.0-MMIO)</u>

结构参数 1 (HCSPARAMS1) 默认值:05000420h

少量	属性	默认	描述	助记符
31:24	反渗透	05点	端口数 (MaxPorts)。 该字段指定物理下行端口的数量 在此主机控制器上实现。该字段的值决定了有多少个端口寄存器 可在操作寄存器空间中寻址(参见表 26)。有效值在范围内 1小时到 FF 小时。	最大港口
23:19	反渗透	0	保留的中断	预订的
18:8	反港道	04 J\ 3 9	器数量 (MaxIntrs)。 该字段指定在该主机控制器上实现的中断器的数量。每个中断器 被分配给MSI-X向量并控制其生成和调节。 该字段的值决定了运行时寄存器空间中可寻址的中断寄存器组数量(参见第 5.5 节)。有效值范围为 1 小时至 400 小时。该字段中的"0"未定义。	最大整数
7:0	反渗透	20/J 43	设备插槽数 (MaxSlots)。 该字段指定设备的最大数量 该主机控制器可以支持的上下文结构和门铃数组条目。有效值为 取值范围为1~255。"0"为保留值。	最大槽数



偏移地址:0B-08h(USB3.0-MMIO)

结构参数 2 (HCSPARAMS2) 默认值:FC000031h

少量	属性	默认	描述	助记符
31:27	反渗透	1Fh	最大暂存器缓冲区(Max Scratchpad Bufs)。有效值为0-31。该字段表示系统软件应使用的暂存缓冲区的数量	最大SCRB 超滤
			为xHC 保留。更多信息请参见第 4.20 节。	
26	反渗透	1b	暂存器恢复 (SPR)。 如果最大暂存器缓冲区> "0",则此标志指示 xHC 在 执行保存和恢复状态操作时是否使用暂存器缓冲区来保 存状态。如果最大暂存器缓冲区="0",则该标志应为 "0"。更多信息请参见第 4.23.2 节。	
			值 "1"表示 xHC 要求在电源事件期间保持暂存缓	Y
			冲区空间的完整性。	
			值 "0"表示暂存缓冲区空间可以在电源事件 之间释放和重新分配。	
25:21	反渗透	0	最大暂存器缓冲区 (Max Scratchpad Bufs Hi)	最大SCRB 超滤 HI
20:8	反渗透	0	保留事件环	预订的
7:4	反渗透	3/14/5	段表最大值 (ERST Max)。有效值为 0 - 15。此字段 确定事件环段支持的最大值	最大
			表基本大小寄存器 (5.5.2.3.1),其中:	
			事件环段表条目的最大数量 = 2 ERST Max。	
			例如,如果 ERST Max = 7,则 xHC事件环段表最多支持 128	
			条目,15 个条目,然后是 32K 个条目,等等。	
3:0	反渗透	1小时	等时调度阈值 (IST)。	是
		-0	该字段中的值向系统软件指示在添加 TRB 时必须保持在 主机控制器之前的最小距离(时间),以便主机控制器在 正确的时间处理它们。该值应以帧/微帧的数量 来指定。	
			如果 IST 的位 [3] 设置为"0",则软件可以在不晚于IST[2:0] 添加 TRB之前的微帧 TRB 计划执行。	
			如果 IST 的位 [3] 设置为"1",则软件可以在不迟于 IST[2:0] 帧之前添加 TRB	
)	TRB 计划执行。 有关软件如何使用此信息进行调度的详细信息,请参阅第 4.14.2 节	
			同步传输。	



<u>偏移地址:0F-0Ch(USB3.0-MMIO)</u>

结构参数 3 (HCSPARAMS3) 默认值:00E70004h

少量	属性	默认	描述	助记符
31:16	反涉透	00E7h	U2 设备退出延迟。 从 U2 转换到 U0 的最坏情况延迟。 适用于所有根集线器 端口。 以下是允许的值: 值说明 0000h 零 0001h 小于 1 μs。 0002h 小于 2 μs。 07FFh 小于 2047 μs。 0800-FFFFh 保留	U2DEVEX TLT
15:8	反渗透	0	预订的	预订 D
7:0	反渗透	04点	U1 设备退出延迟。 转换根集线器端口的最坏情况延迟 从 U1 到的链路状态 U0。适用于所有根集线器端口。 以下是允许的值: 值说明 00h 零 01h 小于 1 µs 02h 小于 2 µs。 0Ah 小于 10 µs。 0B-FFh 保留	U1DEVEX TLT

<u>偏移地址:13-10h(USB3.0-MMIO)</u>

能力参数 (HCCCPARAMS) 默认值:002841EBh

少量	属性	默认	描述	助记符
31:16	反渗透	0028/J\#J	XHCI 扩展功能指针 (XECP)。 该字段指示功能列表的存在。该字段的值指示从 Base 到第一个扩展功能的开头的相对偏移量(以 32 位字表示)。 例如,利用Base的偏移量为1000h,XECP值为0068h,我们可以计算出第一个扩展能力的有效地址: 1000h + (0068h << 2) -> 1000h + 01A0h -> 11A0h	XECP
15:12	反渗透	4)8]	最大主流阵列大小 (MaxPSASize)。 该字段标识最大大小 Xhc 支持的主码流阵列。主流阵列大小 = 2MaxPSASize+1。 有效的MaxPSASize值为 1 到 15。	MAXPSASI 她
11:9	反渗透	0	保留解析所	预订的
	反渗透	1b	有事件数据 (PAE)	地点
87	反渗透	16	无辅助 SID 支持 (NSS)。 该标志指示主机控制器实现是否支持辅助流 ID。 该比特中的"1"表示不支持辅助流 ID解码。该比特中的"0"表示支持辅助流ID解码。(参见第 4.12.2 节和第 6.2.3 节)。	国家安全局



VIA Lab	s, Inc.		VL805 4 端口 USB 3.0 主机控制器	
6	反渗透	1b	延迟容忍消息传递功能 (LTC)。 该字段表示主机是否 控制器实现支持延迟容忍消息传递 (LTM)。该位中有一个"1"	LTC
			表示支持LTM。该位中的零表示不支持LTM。看	
			有关 LTM 的更多信息,请参阅第 4.13.1 节。	
5	反渗透	1b	轻型 HC 重置功能 (LHRC)。 该字段指示主机控制器是否	伦敦人权委员会
			实现支持轻主机控制器重置。该位中的"1"表示 Light Host	
			支持控制器重置。该位中的"0"表示灯主机控制器复位不	
			支持的。该字段的值影响灯主机控制器重置字段的功能	7
		0	在 USBCMD 寄存器中(参见第 5.4.1 节)。	<u>/</u>
4	反渗透	0	端口指示器 (PIND)。 该位指示xHC根集线器端口是否支持端口	表面
			指标控制。当该位为"1"时,端口状态和控制寄存器包括用于控制端口指示器状态的读/写字段。参见第5.4.8 节的定义	
			端口指示器控制字段。	
3	反渗透	1b	端口功率控制(PPC)。 该字段指示主机控制器实现是否包括端口电源控制。该位中的"1"	个人电脑
			表示端口有端口电源开关。该位中的"0"表示端口没有端口电源开关。	
			该字段的值影响每个端口状态和控制寄存器中端口电源字段的功能(参见第 5.4.8 节)。	
2	反渗透	0	上下文大小 (CSZ)。 如果该位设置为"1",则 xHC 使用 64 字节上下文数据结构。	CSZ
		/	如果该位设置为"0",则 xHC 使用 32 字节 上下文数据结构。	
1	反渗透	1b	注意:此标志不适用于流上下文。	BNC
•	反常姓	15	BW 协商能力 (BNC)。 该字段标识 xHC 是否已实现	BNC
			带宽协商。该字段的值具有以下解释:	
			0b BW 协商未实施_ 1b BW 协商已实施	
			有关带宽协商的更多信息,请参阅第 4.16 节。	
0	反渗透	1b	64 位寻址能力 (AC64)。 该字段记录寻址范围能力	AC64
		_	本次实施的情况。该字段的值决定了xHC是否已经执行	
			64 位寄存器和数据结构指针字段的高位 32 位。该字段的值	
	_	7	有如下解释: 0b32位地址内存指针实现_	
			1b 64位地址内存指针的实现 如果实现 32 位地址内存指针,则 xHC 应忽略高位 32 位	
		7	64位数据结构指针字段,系统软件应忽略高位32位	
			64 位 xHC 寄存器。	
	1	I.	OTEL AND DITED	l .

<u>偏移地址:17-14h(USB3.0—MMIO)</u>

门铃偏移 (DBOFF) 默认值:00000100h

少量	属性	默认	描述	助记符	



31:2	反渗透	40ปรชิว	门铃阵列偏移。 该字段定义了	关闭	
			Doorbell 阵列基地址相对于 Base(即 xHCI 功能寄存器地址空间的基地址)的双字偏移。		
1:0	反渗透	0	预订的	预订的	

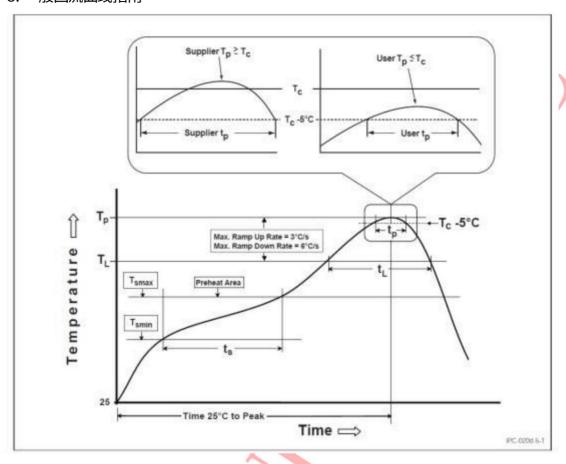
<u>偏移地址:1B-18h(USB3.0-MMIO)</u>

运行时寄存器空间偏移 (RTSOFF) 默认值:00000200h

少量	属性	默认	描述	助记符
31:5	反渗透	10/জ	运行时寄存器空间偏移。 该字段定义 xHCI 运行时寄存器相对于基址的 32 字节偏移量。即 运行时 寄存器基地址 = 基址 + 运行时寄存器设置偏移量。	实时关闭
4:0	反渗透	0	预订的	预订的



8. 一般回流曲线指南



Profile Feature	Sn-Pb Eutectic Assembly	Pb-Free Assembly
Preheat/Soak Temperature Min (T _{emin}) Temperature Max (T _{emax}) Time (t _a) from (T _{amax} to T _{emax})	100 °C 150 °C 60-120 seconds	150 °C 200 °C 60-120 seconds
Ramp-up rate (T _L to T _p)	3 *C/second max.	3 "C/second max.
Liquidous temperature (T _L) Time (t _L) maintained above T _L	183 °C 60-150 seconds	217 °C 60-150 seconds
Peak package body temperature (T _p)	For users T _p must not exceed the Classification temp in Table 4-1. For suppliers T _p must equal or exceed the Classification temp in Table 4-1.	For users T _p must not exceed the Classification temp in Table 4-2 For suppliers T _p must equal or exceed the Classification temp in Table 4-2
Time (t _c)* within 5 °C of the specified classification temperature (T _c), see Figure 5-1.	20° seconds	30" seconds
Ramp-down rate (T _p to T _L)	6 °C/second max.	6 °C/second max.
Time 25 °C to peak temperature	6 minutes max.	8 minutes max.
Tolerance for peak profile temperature (T _p) is defined as a supplier minimum and a us	ser maximum.

Note 1: All temperatures refer to the center of the package, measured on the package body surface that is facing up during assembly reflow (e.g., live-bug). If parts are seflowed in other than the normal live-bug assembly reflow orientation (i.e., dead-bug), T_p shall be within ± 2 °C of the live-bug T_p and still meet the T_c requirements, otherwise, the profile shall be adjusted to achieve the latter. To accurately measure actual peak package body temperatures refer to JEP140 for recommended thermocoupie use.

Note 2: Reflow profiles in this document are for classification/preconditioning and are not meant to specify board assembly profiles. Actual board assembly profiles should be developed based on specific process needs and board designs and should not exceed the parameters in Table 5-2. For example, if T_o is 250 °C and time t_o is 30 seconds, this means the following for the supplier and the user. For a supplier. The peak temperature must be at least 260 °C. The time above 255 °C must be at least 30 seconds. For a user. The peak temperature must not exceed 290 °C. The time above 255 °C must not exceed 30 seconds.

Note 3: All components in the test load shall meet the classification profile requirements.

Note 4: SMD packages classified to a given moisture sensitivity level by using Procedures or Criteria defined within any previous version of J-STD-020, JESD22-A112 (rescinded), IPC-SM-786 (rescinded) do not need to be reclassified to the current revision unless a change in classification level or a higher peak classification temperature is desired.



9. 封装机械规格

红外回流焊的无铅最高温度		
范围	价值250	单元
最高温度Tp	30	°C
Tp 5°C 以内的最长时间		秒
2×△ 000 0	A	
PINJI IDENTRY:Laser Mark	1	Moccial A C
2X 🖂 👓 😅 "B"	_	DETAIL : "B"
SEATING PLANE	THING CIAB	DETAIL: "A"



	Dime	ension in	mm	Dime	ension in i	inch
Symbol	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	0.80	0.85	0.90	0.031	0.033	0.035
A1	0.00	0.02	0.05	0.000	0.001	0.002
A3		0.20 R e F		(0.008 REF	
b	0.15	0.20	0.25	0.006	0.008	0.010
D/ E	7.90	8.00	8.10	0.311	0.315	0.319
D2	6.05	6.20	6.35	0.238	0.244	0.250
E 2	6.05	6.20	6.35	0.238	0.244	0.250
е		0.40 BSC	;	0.016 BSC		
L	0.30	0.40	0.50	0.012	0.016	0.020
R	0.075			0.003		
K	0.20			0.008		
aaa		0.10		0.004		
bbb		0.07		0.003		
ccc	0.10			0.004		
ddd	0.05			0.002		
eee	0.08			0.003		
fff		0.10			0.004	

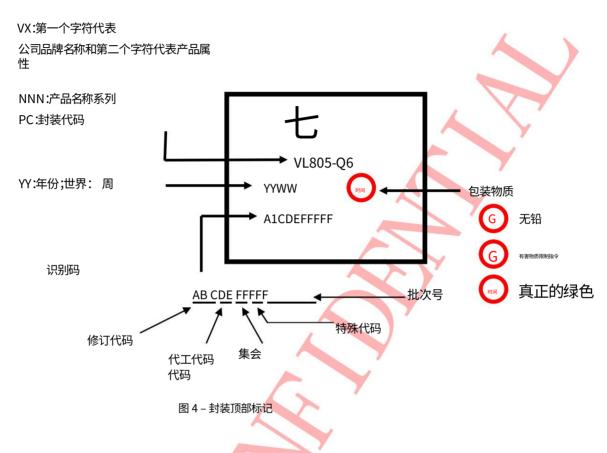
NOTE:

- 1. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER
- 2. REFERENCE DOCUMENT: JEDEC MO-220.





10. 封装顶部标记



11. 订单信息

零件号	包装类型
VL805 – Q6 T	QFN68 8x8 毫米



威盛实验室有限公司

www.via-labs.com

7F, 529-1, Zhongzheng Rd.,

Xindian District, New Taipei City 231 Taiwan

电话: (886-2)2218-1838 传真: (886-2)2218-8924 邮箱:sales@via-labs.com.tw

版权所有© 2010 威盛实验室有限公司。保留所有权利。

未经事先书面同意,不得以任何形式或通过任何方式(电子、机械、磁性、光学、化学、手动或其他方式)复制,传播、转录本文档的任何部分、将其存储在检索系统中或翻译成任何语言。已获得 VIA Labs,Inc. 许可。本文档中的材料仅供参考,如有更改,恕不另行通知。威盛实验室保留更改产品设计的权利,恕不另行通知用户。

所有商标均为其各自所有者的财产。

威盛实验室有限公司的任何专利或专利权均未授予(暗示或以其他方式)许可。威盛实验室有限公司对本文档及其中描述的产品不作任何暗示或其他形式的保证。截至本文件发布之日,本文件提供的信息被认为是准确可靠的。然而,威盛实验室对本文档中的任何错误不承担任何责任。此外,威盛实验室对本文档中信息的使用或误用以及因使用本文档而可能产生的任何专利侵权不承担任何责任。本文档中的信息和产品规格可能随时更改,恕不另行通知,也没有义务将此类更改通知任何人。